

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 3 区分

【発行日】平成 24 年 4 月 12 日 (2012.4.12)

【公開番号】特開 2009-207142 (P2009-207142A)

【公開日】平成 21 年 9 月 10 日 (2009.9.10)

【年通号数】公開・登録公報 2009-036

【出願番号】特願 2009-39050 (P2009-39050)

【国際特許分類】

H 0 1 P 1/04 (2006.01)

H 0 1 P 5/02 (2006.01)

H 0 5 K 1/14 (2006.01)

H 0 1 R 12/79 (2011.01)

H 0 1 R 12/78 (2011.01)

H 0 1 R 12/71 (2011.01)

【 F I 】

H 0 1 P 1/04

H 0 1 P 5/02 6 0 3 E

H 0 5 K 1/14 D

H 0 1 R 23/68 3 0 3 G

【手続補正書】

【提出日】平成 24 年 2 月 23 日 (2012.2.23)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

少なくとも 1 つの第 1 の伝送ライン、および、前記第 1 のラインの一つの先端にある少なくとも 1 つの金属ホールを含む第 1 の基板上の相互接続手段であって、

前記金属ホールは、前記基板の 2 つの面上で非金属化されたセービングにより囲まれており、前記金属ホールと前記伝送ライン部分に関連する前記第 1 の基板の接地面との間に形成された前記セービングは、第 1 のフィルタ素子を形成する、相互接続手段。

【請求項 2】

前記フィルタ素子の回路網は、自己インダクタンス素子および並列の共振素子によって構成され、低域通過型応答を示す、請求項 1 に記載の相互接続手段。

【請求項 3】

前記共振素子の値は、前記金属ホールと前記第 1 の基板の前記接地面との間の前記セービングの大きさの関数である、請求項 2 に記載の相互接続手段。

【請求項 4】

前記誘導素子の値は、前記セービング上の前記伝送ラインの大きさの関数である、請求項 2 に記載の相互接続手段。

【請求項 5】

前記第 1 の基板の前記伝送ラインは、ライン素子により前記金属ホールを越えて延びている、

請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 6】

第 2 の基板上にある第 2 の伝送ラインを延設する突出部が前記金属ホールへ挿入され、
前記突出部は、伝送ライン部分、および、接地セービングを含む、
請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 7】

前記第 2 の基板の前記伝送ライン部分は、前記金属ホールに挿入され、かつ、その反対
側の接地セービングは、追加のフィルタ素子を形成する、
請求項 6 に記載の相互接続手段。

【請求項 8】

前記追加のフィルタ素子は、自己インダクタンス素子である、
請求項 7 に記載の相互接続手段。

【請求項 9】

前記誘導素子の値は、前記セービング上の前記伝送ラインの長さの関数である、
請求項 8 に記載の相互接続手段。

【請求項 10】

前記第 2 の基板の前記突出部の部分は、第 2 の供給ラインを受け入れる面の反対側の面
上で非金属化されている、
請求項 6 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 11】

前記第 1 および第 2 の伝送ラインは、マイクロストリップ・ライン、コプラナー・ライ
ン、または、プレート・ラインである、
請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 12】

前記第 1 および第 2 の基板は、単一層または多層基板である、
請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。